



MID-Förderpreis

der Forschungsvereinigung
Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V.

Ausschreibung 2014

1. Präambel

Die Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V. verleiht den MID-Förderpreis an Absolventen/innen technischer Hochschulen/Universitäten und Fachhochschulen für wegweisende wissenschaftliche Arbeiten zur MID-Technologie. Der Preis ist mit einer Urkunde und 1.000,- € dotiert.

Räumliche Spritzgegossene Schaltungsträger (Molded Interconnect Devices – MID) sind strukturiert metallisierte Spritzgusskörper mit integrierten Leiterzügen. Dadurch vereint diese Produktinnovation elektrische und mechanische Funktionen in einem Bauteil und trägt so zur Verringerung der Produktionskosten und zur Verbesserung der Produkteigenschaften bei. Zur Förderung und Weiterentwicklung dieser Technologie wurde im Herbst 1992 die gemeinnützige Forschungsvereinigung 3-D MID e.V. gegründet. Mitglieder sind derzeit 70 Firmen und 24 Hochschul- und Forschungsinstitute.

2. Vergabe-Richtlinien

Mit dem "MID-Förderpreis" der Forschungsvereinigung werden Absolventen/innen einer Technischen Hochschule/Universität oder Fachhochschule in Deutschland ausgezeichnet, die eine hervorragende wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der MID-Technologie angefertigt haben. Hierzu zählen insbesondere die Bereiche:

- 1. Innovationen in MID:**
Integrative Produktkonzepte; wirtschaftliche Aspekte; Markterschließung
- 2. MID – Anwendung und Realisierung:**
Erweiterter Nutzen durch MID; Auswahl von MID-Herstellungsverfahren; Strategien für erfolgreiche MID-Projekte
- 3. Integrierte CAD/CAM-Systeme:**
Entwicklungssysteme ECAD/MCAD; 3D-MID-Layout und Design; Simulation
- 4. Materialien für MID:**
Einsatz neuer Substrate/Folien; Schaltungsträger-Oberflächen; Verbindungsmedien
- 5. Herstellungsverfahren:**
Kunststoffverarbeitung; Metallisierungsverfahren; Strukturierung von Leiterbahnen

6. Aufbau- und Verbindungstechnik:

Bestücken: SMT, THT, Chip on MID; alternative Lötverfahren, Leitleben; Systemlösungen für MID, Folie

7. Qualitätssicherung:

Qualitätssichernde Maßnahmen; Umweltschutz, Recycling; Prüfmethodik, Standards

8. Zukünftige Entwicklungen:

Drucktechnologien; alternative Aufbautechnologien; Rapid Prototyping/Manufacturing

Die Beiträge sollen von den Fakultäten und Fachbereichen der Hochschulen und Fachhochschulen angenommene wissenschaftliche Arbeiten der letzten 2 Jahre sein. Jede einzureichende Arbeit ist mit einer gutachterlichen Stellungnahme des betreuenden Professors zu versehen.

3. Aufruf zur Bewerbung um den Förderpreis

Die Vorschläge können nur durch die betreuenden Professoren eingereicht werden. Es wird gebeten, mit den Vorschlägen folgende Unterlagen einzureichen:

- wissenschaftliche Arbeit
- gutachterliche Stellungnahme durch den jeweiligen Hochschullehrer
- Lebenslauf des Bewerbers

Einsendeschluss für die Einreichung ist Freitag, der 20. Juni 2014.

4. Auswahl der prämierten Arbeiten

Die eingereichten Arbeiten werden durch den Forschungsbeirat der Forschungsvereinigung 3-D MID e.V. beraten und beurteilt. Die Benachrichtigung der Preisträger erfolgt bis zum 15. Juli 2014. Der "MID-Förderpreis" der Forschungsvereinigung wird im Rahmen des 11. Internationalen Kongresses Molded Interconnect Devices 2014 vom 24. bis 26. September 2014 in Fürth verliehen.

5. Einsendung und Rückfragen

Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V.
Fürther Straße 246b, 90429 Nürnberg
Tel. +49 911 5302-9100
Fax. +49 911 5302-9102
E-Mail: info@3dmid.de

Erlangen, den 3. April 2014



Prof. Dr. Jörg Franke
1. Vorsitzender



Dr. Ingo Kriebitzsch
Forschungsbeiratsvorsitzender